



电子周报：硬科技龙头未来 3 年国产化机会确定性强 汽车和物联网需求将持续强劲



近期市场关于部分芯片和元器件价格有分歧，投资者关注度也很高，我们再次重申，硬科技的核心主线是国产化，我们继续看好半导体的国产化投资机会。尤其是在原来较为薄弱的工业类环节，我们看到未来国内龙头公司将有望实现市占率数倍的提升。半导体设备材料细分赛道龙头北方华创、至纯科技、长川科技、芯源微、万业企业、雅克科技、神工股份、彤程新材、华懋科技等将持续受益。

从需求上来看，汽车电子和物联网未来数年也将具备强劲的增长势能，汽车电动化带来高压功率芯片价值量大幅提升，另外电动化和智能驾驶带来整体架构的升级，对于元器件、功率芯片、传感器、分立器件等需求也大幅提升，尤其是今年我们看到传统欧系品牌都完成了向电动化的大幅升级，未来 5 年将会带来需求持续景气。闻泰科技、三环集团、顺络电子、法拉电子、士兰微、斯达半导和中车时代等都将受益景气和国产化双驱动。

另外物联网带动 SOC、MCU 和蓝牙等需求继续快速增长，瑞芯微、圣邦股份、思瑞浦、卓胜微、韦尔股份、兆易创新和恒玄科技等也将迎来长期行业红利。

风险提示：1、行业景气度下滑。2、行业制造管理成本上升。

关键词：物联网 芯片

我们的产品



大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34494

